



SLE, una divisione di Tundra, offre un IP Core per il protocollo di interconnessione Interlaken ad alta velocità
Silicon Logic Engineering sviluppa un IP Core scalabile per i dispositivi di comunicazione di prossima generazione

Eau Claire, Wisconsin- 23 gennaio 2007 – Silicon Logic Engineering Inc. (SLE), una divisione di servizi di progettazione di semiconduttori di fascia alta di Tundra Semiconductor Corporation ha annunciato oggi lo sviluppo di un IP Core per il protocollo Interlaken destinato a essere utilizzato nelle progettazioni ASIC o FPGA.

Interlaken IP Core di SLE è scalabile e le prime versioni offrono una larghezza di banda da 10 Gbps a più di 60 Gbps attraverso l'interfaccia. Le prossime versioni offriranno una larghezza di banda superiore a 130Gbps. Questa scalabilità rende Interlaken idealmente adatto alle generazioni multiple dei futuri switch di rete, router e dispositivi di archiviazione. La scalabilità è ottenuta tramite la combinazione della velocità SERDES (da 3,125 Gbps a 6,375 Gbps) e un numero variabile di canali SERDES (da 1 a 24).

Progettato e collaudato per essere facilmente sintetizzabile su molte tecnologie ASIC e FPGA, Interlaken IP Core di SLE è stato costruito esclusivamente per funzionare con i SERDES disponibili in commercio e provenienti dai maggiori fornitori di tecnologia. L'uso di SERDES collaudati di determinati fornitori permette ai clienti di SLE di integrare velocemente l'Interlaken IP Core nella tecnologia a scelta del cliente.

Le specifiche aperte di Interlaken sono il frutto di una collaborazione tra Cortina Systems e Cisco Systems per offrire un protocollo di interfaccia chip-to-chip di gran lunga più scalabile rispetto ai precedenti protocolli. Interlaken combina i vantaggi delle diffuse interfacce SPI4.2 e XAUI basandosi sulla canalizzazione e sulle caratteristiche di controllo di flusso per canale della SPI4.2, e riducendo il numero di pin di I/O del chip utilizzando la tecnologia ad alta velocità SERDES, simile alla XAUI.

Jeff West, vicepresidente dei Servizi di Progettazione di Tundra, oggi ha affermato "Tundra ha nuovamente dimostrato di detenere la leadership nelle tecnologie di interconnessione, aggiungendo Interlaken alla sua gamma di IP e servizi e collaborando con i nostri partner per offrire ai clienti soluzioni innovative".

"Lavorando con SLE, i clienti possono approfittare di Interlaken, un'interfaccia di sistema dalle elevate prestazioni e standard aperti per dispositivi di comunicazione," ha detto Zino Chair, vicepresidente Marketing di Cortina Systems. "Interlaken permette ai fornitori di silicio di scalare i componenti sino a 40Gbps e oltre, semplificare le progettazioni e ridurre i costi di sviluppo."

"Gli utenti di Interlaken IP di SLE scopriranno che è più facile valutare, integrare e produrre prototipi rispetto alle precedenti interconnessioni IP," ha dichiarato Matt Weber, Senior Hardware Engineer e Capo progettista di SLE. "Lo sviluppo di SLE è già cominciato e al momento stiamo lavorando con i primi clienti e i più importanti fornitori di ASIC e FPGA per offrire Interlaken in tecnologie multiple, come abbiamo fatto con il nostro IP SPI4.2."

Disponibilità del prodotto

Il prodotto licenziabile Interlaken IP di SLE è disponibile presso la rete di vendita SLE. Per domande relative alla vendita, contattare le vendite sales@siliconlogic.com o chiamare SLE al numero 1-908-580-1870.

Informazioni su Tundra

Tundra Semiconductor Corporation (TSX:TUN) è leader mondiale nella fornitura di dispositivi di interconnessione di sistemi. Offre supporto tecnico e assistenza clienti di livello mondiale e soluzioni che non temono confronti in fatto di semiconduttori e di servizi di progettazione per i principali fornitori operanti nei settori delle telecomunicazioni, del networking, dei sistemi di archiviazione e information technology. Grazie alle continue innovazioni a livello di prestazioni di sistema che consentono un più rapido ingresso sul mercato, i prodotti Tundra System Interconnect assicurano vantaggi competitivi per le applicazioni relative a infrastrutture wireless, reti di archiviazione, accesso alle reti, applicazioni militari, automazione industriale e information technology. Silicon Logic Engineering, Inc. (SLE), una sussidiaria interamente controllata di Tundra, offre servizi di progettazione di semiconduttori all'avanguardia nel settore, consulenza su proprietà intellettuale e strumenti di sviluppo del prodotto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://www.tundra.com>.

Informazioni su Silicon Logic Engineering

Silicon Logic Engineering, Inc. (SLE) è un'azienda specializzata in servizi di progettazione "corretti fin dal primo tentativo" che copre tutti gli aspetti dei servizi di progettazione ASIC, FPGA e di sistemi a semiconduttori. Il collaudato e ripetibile processo di progettazione Think Physical™, gli strumenti di sviluppo e igli IP core di SLE riducono i tempi di commercializzazione e sono forniti da uno dei gruppi di servizi di progettazione per circuiti VLSI con più esperienza sul mercato. SLE è una divisione di Tundra Semiconductor Corporation ([TSX:TUN](http://www.tundra.com)). Maggiori informazioni su SLE sono disponibili sul sito <http://www.siliconlogic.com>.

Informazioni su Cortina Systems

Cortina Systems, Inc. è fornitore leader di soluzioni di comunicazione intelligente attraverso continue innovazioni nell'elaborazione avanzata delle porte e nella connettività intelligente delle porte per i segmenti di mercato Core, Metro, Access ed Enterprise. Grazie alla nostra integrazione digitale analogica ad alta velocità e all'avanguardia, offriamo un'ampia gamma di prodotti che soddisfano le esigenze di prestazioni, densità e flessibilità dei nostri clienti e consentono tempi di commercializzazione più rapidi, maggiore durata sul mercato e maggiore redditività. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per comprenderne le esigenze e anticiparne le necessità, stiamo creando gli elementi essenziali per un nuova generazione di servizi. Maggiori informazioni su Cortina Systems sono disponibili sul sito <http://www.cortina-systems.com>.

SLE, il logo SLE e Think Physical sono marchi commerciali di proprietà di Silicon Logic Engineering, Inc. TUNDRA e il logo Tundra sono marchi depositati di Tundra Semiconductor Corporation in Canada, Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese (Registrazione in corso negli Stati Uniti). Design.Connect.Go. è un marchio di fabbrica di Tundra Semiconductor Corporation.

(C) Copyright 2007 Silicon Logic Engineering, Inc. Tutti i diritti riservati. Informazioni soggette a modifica senza preavviso

Richieste di informazioni per i media:

Nord America	Europa	Cina
Anna Sizer	Rob Davies	Jo Soo
Sizer Communications LLC	+ 44 (0)1225 470000	+ 852.2837.4727
1.715.533.0155		
Anna@sizercommunications.com	rob.davies@publitek.com	jo.soo@edelman.com

Definizioni:

ASIC: Application Specific Integrated Circuit (circuito integrato per applicazioni specifiche)

ASIC di alta gamma: tecnologia da 90nm o più piccola, 30 milioni o più di gate, con o senza stringenti requisiti di potenza.

FPGA: Field Programmable Gate Array (dispositivi programmabili dinamicamente)

I/O Pin: Pin di ingresso e uscita

IP: Proprietà intellettuale. Questo comunicato stampa si riferisce a blocchi IP ASIC o FPGA licenziabili.

Interlaken: Un protocollo di interfaccia chip-to-chip ultrascalabile scritto come una specifica aperta da Cortina Systems e Cisco Systems, sviluppato come IP ASIC e FPGA licenziabile da SLE.

SERDES: Un ricetrasmittitore SERDES (serializzatore/deserializzatore) converte dati paralleli in e da dati seriali, riducendo in tal modo il numero di segnali necessari in un'interfaccia chip-to-chip.

SPI4.2: Il System Packet Interface Livello 4 Fase 2 è un'interconnessione ad alta velocità per applicazioni con larghezza di banda aggregata di 10Gbps. Lo standard SPI4.2 è stato redatto da Optical Internetworking Forum <http://www.oiforum.com>. Lo SPI4.2 viene anche abbreviato in SPI-4.2, SPI-4 Fase 2 e SPI Livello 4 Fase 2.

VLSI: Very Large Scale Integration (integrazione su larghissima scala)

XAUI: Un'interconnessione chip-to-chip che utilizza quattro canali di dati seriali di 3,125Gbps. XAUI è definita dalla IEEE802.3ae e utilizzata in sistemi 10 Gigabit Ethernet (10GbE).